

# 电子元器件（失效分析）检测-材料分析及检测

产品名称	电子元器件（失效分析）检测-材料分析及检测
公司名称	百检综合检测商城
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	15000396480 15000396480

## 产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供电子元器件（失效分析）检测、电子元器件（失效分析）检验、电子元器件（失效分析）第三方检测、电子元器件（失效分析）质检报告、电子元器件（失效分析）计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 微电子器件试验方法和程序方法 2012.1：X射线照相 GJB 548B-2005 X射线照相

2 环境测试-第二部分：通过润湿平衡法对贴片电子组件进行焊接性能测试 EN 60068-2-69：2017 IEC 60068-2-69：2017 可焊性试验

3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验Ta:润湿称量法可焊性 GB/T 2423.32-2008 可焊性试验

4 元器件引线、端子、焊片、接线柱和导线的可焊性测试 IPC/JEDEC J-STD-002E-2017 可焊性试验

5 印制板可焊性测试 J-STD-003C-2017 可焊性试验

6 微电子器件试验方法和程序 方法2009.1外部目检 GJB 548B-2005 方法2009.1 外部目检

7 电子组件的可接受性 IPC-A-610G : 2017 外部目检

8 军用电子元器件破坏性物理分析方法 工作项目1103 塑封半导体集成电路 GJB 4027A-2006  
2.5.2.4.2 开盖

9 切片方法手册 IPC-TM-650-2015 2.1.1 F 微观切片检测试验

10 电子组件的可接受性 IPC-A-610G : 2017 微观切片检测试验

11 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005 微观切片检测试验

12 微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 16594-2008 扫描电子显微镜

13 金属覆盖层 厚度测量 扫描电镜法 GB/T 31563-2015 扫描电子显微镜

14 微电子器件试验方法和程序方法2018.1 : 扫描电子显微镜 ( SEM ) 检查 GJB  
548B-2005 扫描电子显微镜

15 电子探针和扫描电镜X射线能谱定量分析通则 GB/T  
17359-2012 电子探针和X射线能谱定量分析元素含量实验